

 INDUSTRIAL SURFACE SOLUTIONS	QM-Handbuch Technisches Datenblatt - S-Bond® 115 -	Version: 16.10.2026 ISO 9001
---	---	---

Beschreibung

S-Bond®115-1 ist ein In-Sn-Ag-Ti-basiertes aktives Lötmedium, welches eine Reihe von Metallen, Leichtmetallen und keramischen Materialien verbindet.

Schmelzbereich

- Solidus Temperatur: 109 °C (228,2 °F)
- Liquidus Temperatur: 118 °C (244,4 °F)
- Verbindungstemperatur: 125– 130 °C (257 – 266 °F)

Physikalische Eigenschaften

- Dichte: 8,6 g/cm³
- Thermischer Ausdehnungskoeffizient von R.T. 25 bis 100 °C (300 °F):
~19 x 10⁻⁶/ °C
- Elektrischer Widerstand (ρ): 11 - 12 μ-Ohm-m
- Wärmeleitfähigkeit:
 - Intrinsic: 65 W/mK

Mechanische Eigenschaften

- Zugfestigkeiten UTS 0,2% Y.S.
 - 25 – 75 °C 35 MPa
- Verbindungsfestigkeit (R.T.):

Aluminium zu Aluminium:	20 – 25 MPa
Stahl zu Stahl:	20 –30 MPa
Edelstahl (Typ 304):	18 – 25 MPa
Kupfer zu Kupfer:	20 – 30 MPa
Aluminium zu Stahl:	20 – 25 MPa
Al:SiC zu Metall:	30 – 41 MPa
Glas zu Metall:	24 – 35 MPa

Gemeinsame Dichtungsfähigkeiten

- Hermetische Dichtigkeit 5 x 10⁻¹⁰ mbar*L/sec (Helium-Leckagerate)

EUROMAT GMBH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der o.g. Werte. Werte wurden im Labor ermittelt und können chargenmäßig abweichen. Es empfiehlt sich die eigene Überprüfung nach Warenerhalt.